



Dirección de Investigación e Innovación – Sede principal
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI-
USTA

Por: Cristian Alexander Vega Mosquera, Camilo A. Corchuelo R. y Luz Marina Paez

1

Observatorio de cienciometría USTA



RESUMEN

Este informe de entrega una consulta del estado de las patentes del tema “Interconexión y Convergencia” de forma general. Se presenta la publicación y presentación por año, las palabras con mayor concurrencia, información de asignación por solicitantes y caracterización por industria y países. Este es un insumo para la comunidad académica USTA cuyo objetivo es potenciar la transferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo del país.

Palabras Claves: Patentes, Informe de patentes, Interconexión, Convergencia

ABSTRACT

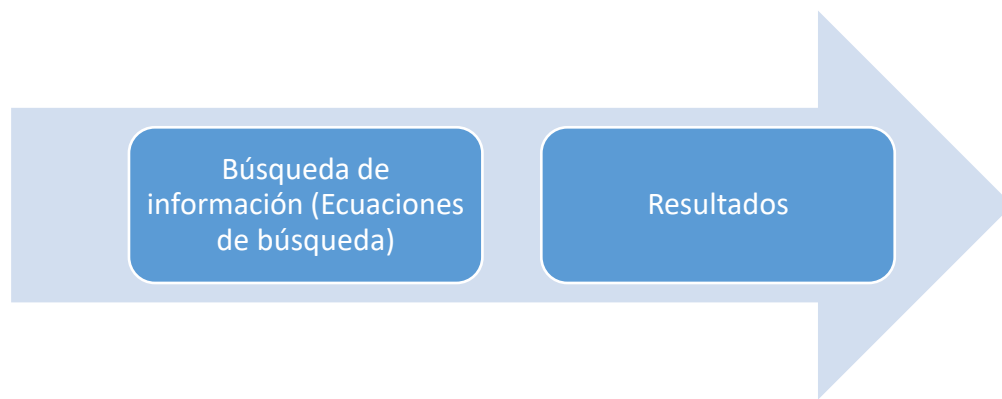
This report provides a general patent status query on the topic "Interconnection and Convergence". The publication and presentation by year are presented, the words with the highest concurrence, allocation information by applicants and characterization by industry and countries. This is an input for the USTA academic community whose objective is to promote the transfer of knowledge and technology to the country's productive sector.

Keywords: Patents, Patent Landscapes Reports, Interconnection, Convergence

Ficha técnica

Fuente	Expresión de búsqueda
Innovation IQ Plus - IEEE	“Interconnection and Convergence”
Periodo de análisis:1940 – 2020	
Fecha de consulta: 2/11/2020	

Metodología



[1]

Resultados

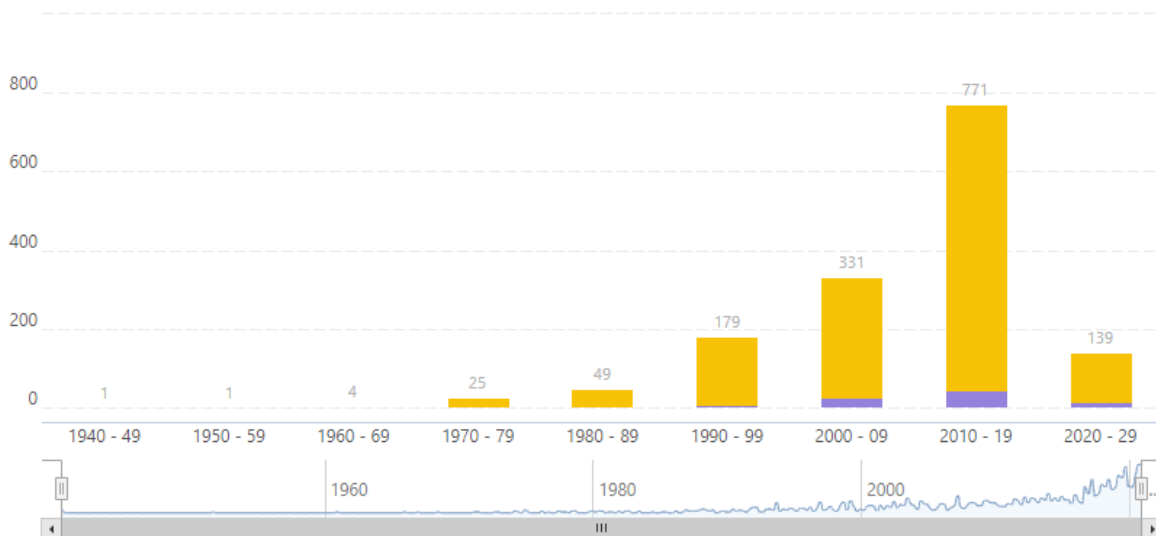


Gráfico 1. Patentes por año (Fuente: IQ Plus)

PATENT LANDSCAPES REPORTS

Observatorio de cienciometría USTA

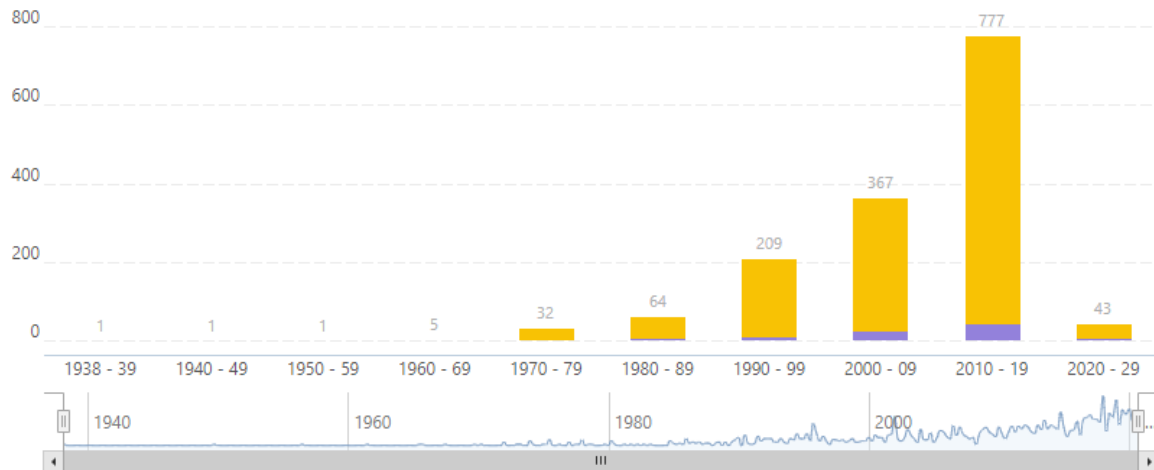


Gráfico 2. Aplicaciones por año (Fuente: IQ Plus)

access address algorithm architecture beam bus calculate call cell chip circuit
communication computer connect **connected** controller converge current data
determine end equation extend fiber figure first form frequency generate hole image
implement information input interconnect **interconnection** interface
layer lens light local material memory message model module mount
network node optical output packet parameter plate port portion
power program protocol receive route send server service side signal
step store substrate surface switch technology terminal transmission transmit
user value voltage wafer wire

Gráfico 3. Nube de palabras de las palabras con mayor concurrencia en las patentes (Fuente: IQ Plus)

PATENT LANDSCAPES REPORTS

Observatorio de cienciometría USTA

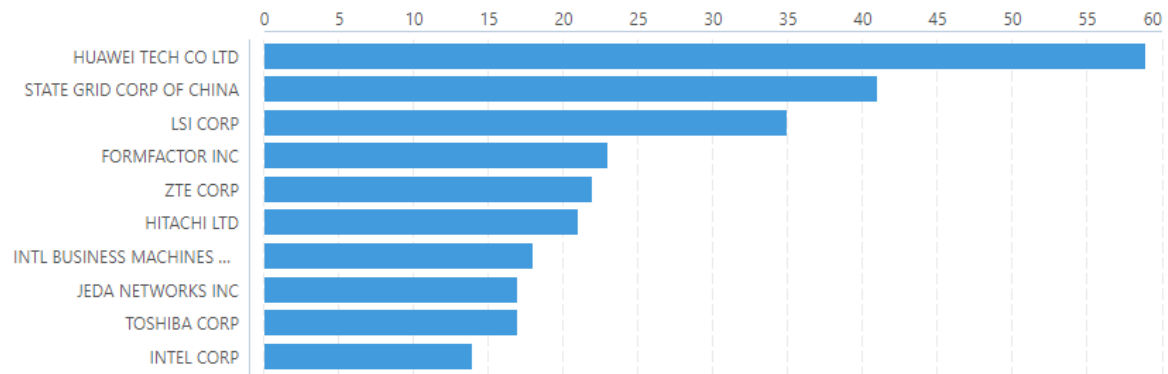


Gráfico 4. Top 10 de los mayores solicitantes (Fuente: IQ Plus)

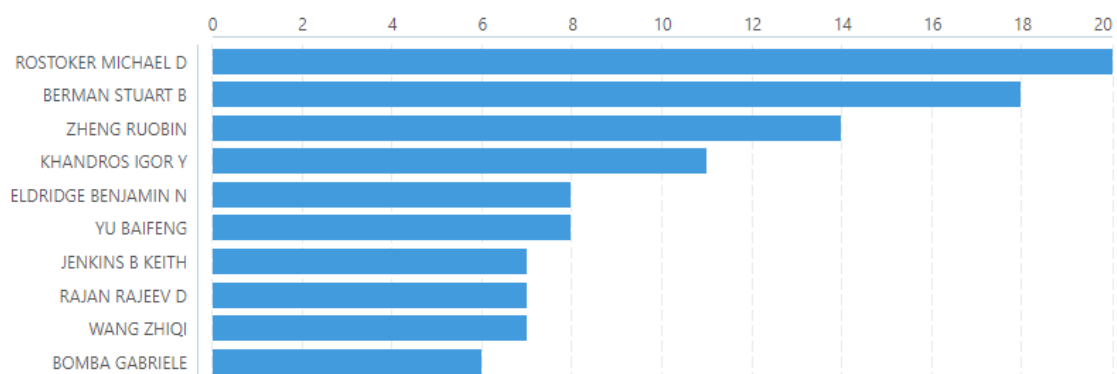


Gráfico 5. Top 10 del primer inventor con más patentes (Fuente: IQ Plus)

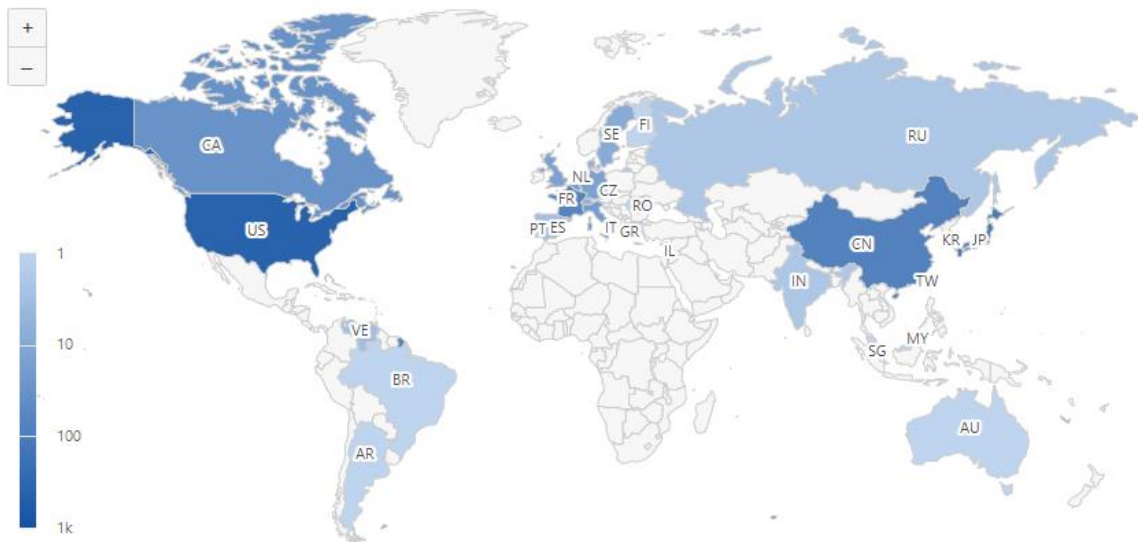


Gráfico 6. Mapa de patentes por el país de origen basado en el inventor (Fuente: IQ Plus)

PATENT LANDSCAPES REPORTS

Observatorio de cienciometría USTA

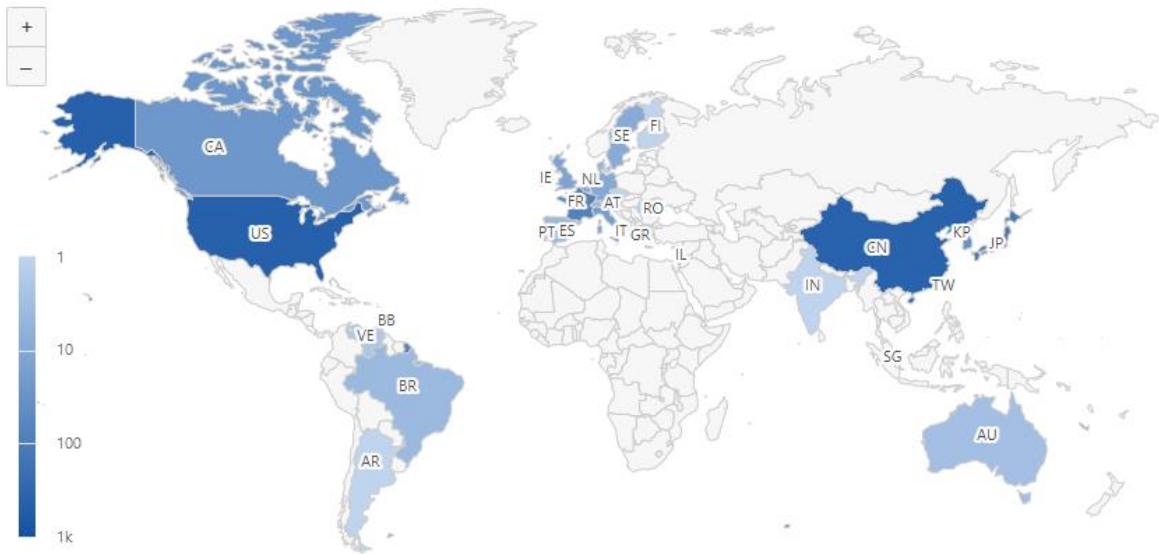


Gráfico 7. Mapa de patentes por el país de origen basado en el primer solicitante (Fuente: IQ Plus)



Gráfico 8. Primer cesionario por CPC (Fuente: IQ Plus)

PATENT LANDSCAPES REPORTS

Observatorio de cienciometría USTA



Tabla 1. Top 10 de las Patentes más recientes

Publication Number	Title	Publication Date	Application Number	Application Date	Earliest Priority Date	Current Assignee First	Ultimate Parent First	Inventor First
CN110022251A	A kind of service convergence system based on IP interconnection function	2019-07-16	CN 201910092032 A	2019-01-30	2019-01-30	STATE GRID ZHEJIANG NINGBO YINZHOU POWER SUPPLY CO LTD	STATE GRID ZHEJIANG NINGBO YINZHOU POWER SUPPLY CO LTD	ZHANG WENBO
CN101459501A	Multi-frame interconnecting system and inter-frame data transmission method	2009-06-17	CN 200810190122 A	2008-12-31	2008-12-31	ZTE CORP	ZTE CORP	WEIMIN ZHA
US20150113580	Convergence Terminal and Method for Providing Multi-Service by Convergence Terminal	2015-04-23	US 14/585,996	2014-12-30	2012-08-02	HUAWEI DVC CO LTD	HUAWEI INVESTM & HLDG CO LTD	HE ZHIQIN
EP2866429A1	Integrated terminal and method for providing multi-service therefrom	2015-04-29	EP 12882007 A	2012-08-02	2012-08-02	HUAWEI DVC CO LTD	HUAWEI INVESTM & HLDG CO LTD	HE ZHIQIN

PATENT LANDSCAPES REPORTS

Observatorio de cienciometría USTA



US5452183	Chip carrier system	1995-09-19	US 8/218,550	1994-03-28	1994-03-28	WHITAKER LLC	TE CONNECTIVITY LTD	RENN ROBERT M
JP3375658B2	Parallel computer and network for it	2003-02-10	JP 1992-63065 A	1992-03-19	1992-03-19	HITACHI VLSI ENG CORP	HITACHI VLSI ENG CORP	TAKEUCHI SHIGEO
CN106844263B	Configurable multiprocessor-based computer system and implementation method	2020-07-03	CN 201611215355 A	2016-12-26	2016-12-26	INST COMPUTING TECH CHINESE ACAD SCIENCES	CHINESE ACAD SCIENCES	AN XUEJUN
CN107480404B	Optical interconnection module coupling efficiency prediction method based on driving quantity term neural network	2020-09-11	CN 201710823530 A	2017-09-13	2017-09-13	GUILIN UNIV ELTNC TECH	GUILIN UNIV ELTNC TECH	HUANG CHUNYUE
CN204176217U	A kind of distributing and converging device	2015-02-25	CN 201420611054 U	2014-10-21	2014-10-21	GUOWANG INTELLIGENCE TECH CO LTD	GUOWANG INTELLIGENCE TECH CO LTD	JIANG KEQIANG
TW201721452A	System capable of automatically setting PCIe module	2017-06-16	TW 104141753 A	2015-12-11	2015-12-11	LANNER ELTNC INC	LANNER ELTNC INC	WU JUI-MIN

Nota: Fuente: IQ Plus

PATENT LANDSCAPES REPORTS

[1] C. A. Corchuelo-Rodriguez, A. E. Barreto Montenegro, J. D. López Báez, y O. L. Ostos Ortiz, «Boletín bibliométrico USTA - No. 1 (2019)», vol. N. 1, p. 72, jun. 2019, doi: <https://doi.org/10.15332/dt.inv.2019.00138>.